

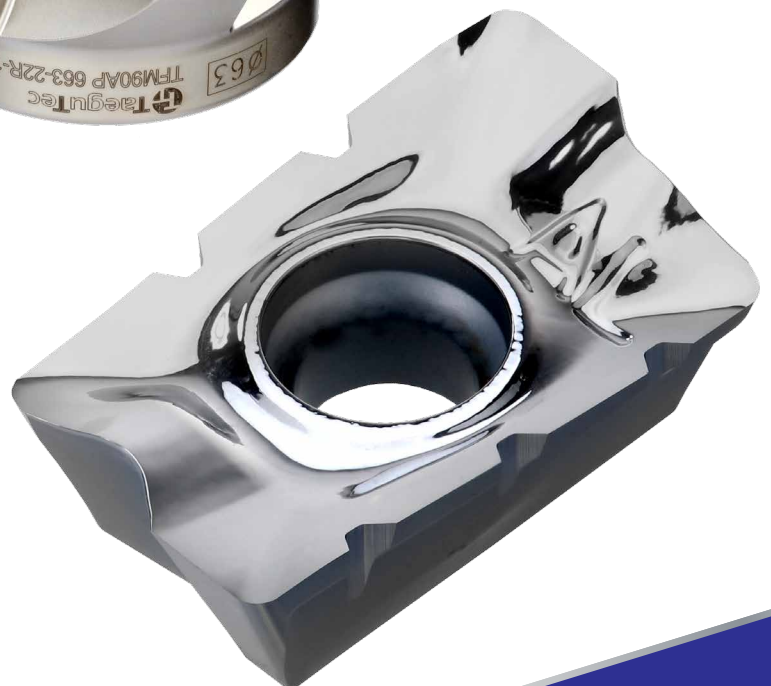
# NPN

New Product News



## CHASEMILL

알루미늄 가공용 칩 분할 인서트



## KEY POINT

대구텍은 CHASE-MILL 라인에 알루미늄 가공용 칩 분할 인서트를 신규 출시합니다.

알루미늄 가공용 칩 분할 인서트는 진동이 우려되는 긴 오버행 및 불안정한 치구의 알루미늄 가공에서 안정적인 가공으로 높은 생산성을 확보할 수 있습니다.

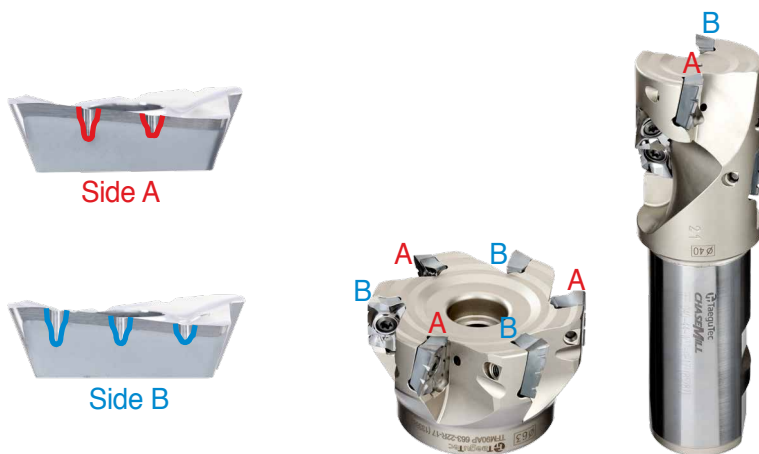
새로운 칩 분할 인서트는 CHASE-MILL 라인의 APCT 17 사이즈로 공급되며 기존의 표준 커터에 별도의 수정없이 사용 가능합니다.

### 특징

- 저마력 장비, 불안정한 치구 및 오버행이 긴 알루미늄 가공에서 안정된 가공
- 절삭 저항 감소로 고이송 적용 및 생산성 향상
- 칩 분할을 통한 원활한 칩 배출 및 칩 볼륨 감소

### 주의

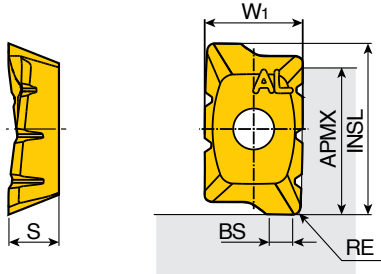
- 인서트 체결 시, 커터의 첫번째 포켓은 2개의 홈 인선을, 두 번째 포켓은 3개의 홈 인선이 오도록 체결되어야 하며, 나머지 포켓도 이와 같이 반복적으로 체결 하십시오.
- 칩 분절 능력을 최대화하기 위해서는 짝수 날수를 가진 커터 사용을 권장합니다.



## APCT 17



### 칩 분할 인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
<b>17-SAL</b>	18.5	10.8	5.62	16.1	2.56	0.8



인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080		TT2510	
	<b>APCT 1705 PER-SAL</b>	4.5-13.0	0.50-0.10											● K10

●: 표준 제품

## 추천 절삭 조건

### 절삭 가공 조건

절삭속도: Vc(m/min)

ISO	피삭재 재질	조건	인장강도 Rm (N/mm <sup>2</sup> )	경도 (HB)	소재 그룹	비코팅	
						K10	
N	알루미늄 합금 -단조합금	시효경화처리 안됨		60	21	550-700	
		시효경화처리		100	22	600-750	
	알루미늄 합금 -주조합금	<= 12% Si	시효경화처리 안됨		75	23	800-900
			시효경화처리		90	24	650-800
		> 12% Si	고온열처리		130	25	250-320
	구리 합금	> 1% Pb	괘삭합금		110	26	300-400
			황동		90	27	300-400
			전해구리		100	28	210-280
	비철금속		듀로 플라스틱, 탄소강화섬유			29	150-250
			경화 고무			30	150-250

■ 비철금속